

單位	職 掌 概 要	
稽核室	協助董事會及經理人檢查、評估內部控制制度、管理規章及作業流程管理，並提供分析及建議，以確保內部控制制度得以持續有效運作。	
總經理室	<ol style="list-style-type: none"> 1.公司未來短、中、長程發展之營運目標及計畫之擬定及修訂。 2.監督各部室執行營運計畫以達成公司營運目標、追求永續經營。 3.對外公共關係之建立。 	
新竹設計中心	設計一處 設計三處	<ol style="list-style-type: none"> 1.公司短期、中、長期研發計畫之規畫及執行。 2.新產品之研發與認證、專利技術之建立與申請。
	產品佈局一部	<ol style="list-style-type: none"> 1.基本電路元件(含特殊元件)、新舊產品之佈局設計作業。 2.產品除錯/驗證工程之協尋作業。
	設計服務部	<ol style="list-style-type: none"> 1.積體電路代工廠提供之開發工具的管理。 2.積體電路佈局驗證程式的問題排除。 3.積體電路之自動佈局及其驗證。
台北設計中心	設計二處 設計四處	<ol style="list-style-type: none"> 1.公司短期、中、長期研發計畫之規畫及執行。 2.新產品之研發與認證、專利技術之建立與申請。
	產品佈局二部	<ol style="list-style-type: none"> 1.基本電路元件(含特殊元件)、新舊產品之佈局設計作業。 2.產品除錯/驗證工程之協尋作業。
業務中心	產品企劃部	<ol style="list-style-type: none"> 1.新產品行銷策略之建立及執行。 2.新產品開發進度之追蹤與各部門工作之協調。 3.新產品基礎客戶之開發與市場推展。 4.提供產品線總體市場分析報告-TAM analysis。
	業務一部 業務二部 業務三部	<ol style="list-style-type: none"> 1.年度銷售目標及營業計畫之擬定及執行，以達成年度行銷目標。 2.新市場、新客戶之開發，以提升市場占有率。 3.服務客戶各項需求及客戶訴怨受理與處理。
	深圳代表處 上海代表處	<ol style="list-style-type: none"> 1.大陸市場及新客戶之開發，以提升市場占有率。 2.服務客戶各項需求及客戶訴怨受理與處理。
	財務部 人事部	<ol style="list-style-type: none"> 1.統籌公司的財務、會計、稅務及經營分析等事宜。 2.年度預算之編製、彙總及控制。 3.各項理財活動之調度及運用。 4.公司股東會、董事會及股務作業相關事宜。
<ol style="list-style-type: none"> 1.行政制度之擬定與實施、各項人事管理作業之規畫及執行。 2.各項教育訓練之規畫及執行。 3.各項薪酬與獎懲制度之規畫及執行。 		
生產管理中心	生產企劃部	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬定年度生產計畫及物料需求計畫及管理。 2.產能規畫及管理。 3.各項存貨之倉儲、管理與收發。 4.各項成品銷貨運輸作業之管理。 5.各項採購策略、採購計畫之規畫及執行。
	品質保證部	<ol style="list-style-type: none"> 1.公司標準化、品質系統/活動之維護及推動。 2.文件及記錄管制作業。 3.禁限用物質調查及管理。 4.外包廠商之評鑑、品質督導、異常處理。 5.半成品及成品之抽檢。 6.實驗室儀器校正管理。 7.協助產品開發之相關可靠度實驗、失效分析、專利申請。

單位		職 掌 概 要
	產品測試部	<ol style="list-style-type: none"> 1.開發/維護產品相關之測試程式、增加程式功能，使其能提供量產/工程數據。 2.提昇測試程式之偵錯能力，以增進出貨品質；提昇程式效率，節省測試時間。 3.量產產品生產狀況之掌握與維護。 4.提昇工程能力，解決產品相關之技術問題。
系統應用中心	韌體設計部 韌體應用部	<ol style="list-style-type: none"> 1.協助 IC 設計及企劃部門訂定新產品數位電路規格。 2.驗證新開發產品(FPGA/IC)能符合實際應用規格。 3.新產品使用及開發平台發展。 4.標準化產品軟體模組開發。 5.配合業務部門進行新產品的推展。 6.客戶使用產品問題處理及分析。 7.產品量產系統開發。
	硬體應用部	<ol style="list-style-type: none"> 1.協助設計 IC 應用之 PCB 佈局及基本電路元件(含特殊元件)之佈局設計作業。 2.設計 Module 之應用及驗證，確保新開發產品能符合實際應用規格。 3.驗證 IC 應用之溫度測試及特性分析、產品除錯/驗證工程之作業。 4.客戶退貨及故障產品之應用分析。 5.產品應用狀況之掌握與維護。
	工程支援部	<ol style="list-style-type: none"> 1.協助工程師焊接 Module。 2.協助工程樣品製作。 3.提供業務需求的 Module。
	晶片驗證部	<ol style="list-style-type: none"> 1.設計 IC 驗證之 PCB 佈局。 2.設計 Module 之應用及驗證。 3.驗證 IC 應用之溫度測試及特性分析。 4.撰寫特定應用參考設計規格書。 5.確保新開發產品能符合實際應用規格。
	軟體應用部	<ol style="list-style-type: none"> 1.提供客戶標準化軟體程式庫。 2.撰寫標準化軟體程式庫使用說明書。 3.協助客戶順利整合標準化軟體程式庫，讓客戶能自行客製化應用軟體。
	資訊服務部	<ol style="list-style-type: none"> 1.各項電腦化資訊系統軟體、硬體之規畫及執行。 2.各項電信系統及委外工程之協調與管理。 3.協助各部門之工作資訊科技化。